

## Technisches Merkblatt HECK SHP (Siliconharzputz)

### HECK SHP:

Siliconverstärkter organischer Oberputz gemäß. DIN 15824

HECK SHP (Siliconharzputz) wird in Eimern angeliefert und ist als Kratzputzcharakter (KC) oder Reibputz (R) lieferbar:

HECK SHP KC1,0 (Siliconharzputz KC1,0)	Größtkorn ca. 1,0 mm
HECK SHP KC1,5 (Siliconharzputz KC1,5)	Größtkorn ca. 1,5 mm
HECK SHP KC2 (Siliconharzputz KC2)	Größtkorn ca. 2 mm
HECK SHP KC3 (Siliconharzputz KC3)	Größtkorn ca. 3 mm
HECK SHP R2 (Siliconharzputz R2)	Größtkorn ca. 2 mm
HECK SHP R3 (Siliconharzputz R3)	Größtkorn ca. 3 mm

### Eigenschaften:

- leicht zu verarbeiten
- wasserdampfdiffusionsfähig
- wasserabweisend
- lösemittelfrei
- fungizid und algizid ausgerüstet
- Farbtöne: weiß oder nach Color Sensation Farbtonblock, andere Farbtöne auf Anfrage

### Anwendungsbereich:

für den Außenbereich, sockeltauglich, auch auf HECK WDVS MW / L-MW

Für darüberhinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.

### Zusammensetzung:

Polymerdispersion, Pigmente, carbonatische Körnungen, silikoverstärkt

### Technische Daten:

Wasserdampfdurchlässigkeit (EN ISO 7783-2)	0,07 bis 0,23 m V1 hoch / V2 mittel
Wasseraufnahme SHP KC (DIN EN 15824)	W3
Wasseraufnahme SHP R (DIN EN 15824)	W2
Brandverhalten bei Verwendung in HECK MW Dämmsystem:	A2-s1, d0
Brandverhalten bei Verwendung auf mineralischen Untergründen in einer Schichtdicke bis zu 4mm	B-s2,d0

### Verbrauch:

Putzweise:	Verbrauch:
HECK SHP KC1,0 (Siliconharzputz KC1,0)	1,3 bis 1,5 kg/m <sup>2</sup>
HECK SHP KC1,5 (Siliconharzputz KC1,5)	2,0 bis 2,4 kg/m <sup>2</sup>
HECK SHP KC2 (Siliconharzputz KC2)	2,8 bis 3,2 kg/m <sup>2</sup>
HECK SHP KC3 (Siliconharzputz KC3)	3,8 bis 4,2 kg/m <sup>2</sup>
HECK SHP R2 (Siliconharzputz R2)	2,3 bis 2,7 kg/m <sup>2</sup>
HECK SHP R3 (Siliconharzputz R3)	3,5 bis 3,9 kg/m <sup>2</sup>

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um ermittelte Durchschnittswerte aus der Praxis. Es kann je nach Auftragsdicke, Verdünnung, Pigmentierung und Untergrund ein geringfügiger Mehr- oder Minderverbrauch auftreten. Exakte Verbrauchsmengen sind durch Anlegen von Probeflächen zu ermitteln!

### Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur:

Die Objekt- und Umgebungstemperatur darf nicht unter + 5°C und über + 30°C, bei rel. Luftfeuchtigkeit < 85 % liegen. Ein Unterschreiten der Temperaturen während der Erhärtungsphase (mehrere Tage) kann die Produkteigenschaften nachhaltig ungünstig beeinflussen.

### Putzgrund/ Putzgrundvorbereitung:

Mineralische Putze CS II-IV nach DIN EN 998-1, zementfreie Spachtelmassen, Beton, Faserzement, Putzträgerplatten Außenwandplatten, feste Anstriche. Die Anwendung von Unterputzen der HECK Wall Systems GmbH wird empfohlen, da deren technische Eigenschaften auf die Beschichtung mit HECK SHP (Siliconharzputz) abgestimmt sind. Arbeitsbereich unbedingt vor Beginn der Arbeiten gut abdecken. Der Untergrund muss rissfrei, planeben, sauber, staub- und fettfrei, fest und trocken sein (Kondensatbildung beachten). Unterputze nicht filzen, nur eben abziehen, Mörtelgrate entfernen. Ein Voranstrich mit HECK UG (Universalgrundierung) ist vorzunehmen, am Folgetag kann dann der Putz aufgebracht werden. Alle Unterputze müssen durchgehärtet und trocken sein (Standzeit gemäß gültigem technischem Merkblatt). Im Sockelbereich, auf stark saugenden oder speziellen Untergründen (z. B. Faserzement, Beton) ist ein einmaliger Voranstrich mit HECK TG W PLUS (Tiefengrund W PLUS) erforderlich. Auf ausreichend carbonatisierten oder gering saugenden Untergründen, wie z. B. HECK K+A ZF, darf der Grundieranstrich entfallen.

<b>Verarbeitung:</b>	<p>Bei Bedarf mit max. 1 % sauberen Wasser auf die erforderliche Verarbeitungskonsistenz einstellen. Mit Edelstahltraufel in Kornstärke aufziehen und bei KC-Struktur mit Kunststoff- oder Edelstahltraufel verschleifen. Bei Reibputzstruktur mit Kunststofftraufel arbeiten.</p> <p>Maschinellem Auftrag ist möglich. Es soll nass-in-nass gearbeitet werden, um Stöße zu vermeiden. Bei größeren Flächen soll auf jedem Gerüst ein Mann arbeiten.</p> <p><b>Filzstruktur mit Schwambrett herstellen mit HECK SHP (Siliconharzputz) KC1</b> für Fassadenflächen und Faschenausbildung: HECK SHP (Siliconharzputz) KC1 gut aufrühren und, falls erforderlich, mit Wasser auf entsprechende Verarbeitungskonsistenz einstellen. Anschließend mit Edelstahltraufel gleichmäßig auf Kornstärke auftragen. Nach ausreichendem Anziehen (ca. 15 Min.) kann die Oberfläche mit einem feuchten Schwambrett abgefilzt werden. Um eine gleichmäßige Fläche zu erhalten, ist ein ebener Untergrund erforderlich.</p> <p>Bei kühler Witterung bzw. dauerhaft oder wiederkehrender hoher relativer Luftfeuchte (über 85 %) ist kein Abbinden des Putzes möglich. Auch teilweise erhärteter Putz kann durch Feuchtigkeitseinwirkung erneut angelöst werden.</p>
<b>Nachbehandlung:</b>	Der frische Putz muss bis zur Durchhärtung vor zu schnellem Wasserentzug (Sonne, Wind, hohe Temperaturen), Frosteinwirkung und Regen geschützt werden.
<b>Oberflächenbeschichtung:</b>	Es eignen sich wasserdampfdiffusionsfähige, wasserabweisende Anstrichsysteme, wie z. B. HECK SILCO FF (Siliconharzfarbe), HECK FF, Bei intensiven oder dunklen Farbtöne (HBW < 20) HECK SO-FI LIGHT
<b>Werkzeugreinigung:</b>	sofort nach Gebrauch mit Wasser
<b>Hinweise:</b>	<p>Ausführung und Verarbeitungsbedingungen, wie z. B. Saugfähigkeit des Untergrundes, Witterung oder Umgebungsreflexe können zu Farbtonabweichungen zum Farbtonblock bzw. zum eingereichten Muster führen. Das Anlegen von Musterflächen wird angeraten, da Beanstandungen nach der Verarbeitung nicht mehr anerkannt werden können.</p> <p>Die Verwendung mineralischer Rohstoffe kann zur Folge haben, dass Nachlieferungen im Farbton abweichen. Für zusammenhängende Flächen nur Materialien der gleichen Fertigungscharge verwenden, insbesondere wenn keine Oberflächenbeschichtung erfolgt. Nachlieferungen daher vermeiden. Bei Nachlieferungen grundsätzlich das Datum der Erstbestellung, die Chargennummer sowie Lieferschein-/Rechnungsnummer angeben, nachgeliefertes Material mit evtl. Restmengen gleichmäßig mischen.</p> <p>Für Veränderungen des Farbtones und der Oberflächenstruktur im Laufe der Zeit durch Witterungseinflüsse, z. B. UV-Einwirkung und Umwelteinflüsse, z. B. Atmosphärien (in der Luft vorhandene Partikel), wird keine Gewährleistung übernommen. Die technische Funktionsfähigkeit ist gegeben.</p> <p>Unter ungünstigen Voraussetzungen kann die Bildung von Mikroorganismen, z. B. Algen, nicht ausgeschlossen werden und stellt keinen Reklamationsgrund dar.</p> <p>HECK SHP (Siliconharzputz) ist bereits werkseitig zum Schutz vor Algen- und Pilzbefall biozid ausgerüstet.</p>
<b>Sicherheitshinweise:</b>	Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.
<b>Giscode:</b>	BSW50
<b>Lagerung:</b>	Kühl und im Schatten, frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschließen. Lagerdauer in Originalgebinden ca. 12 Monate.
<b>Qualitätskontrolle:</b>	laufende labormäßige Überwachung der Produktion



Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Mit dieser Ausgabe sind die früheren Technischen Merkblätter ungültig.

**HECK Wall Systems GmbH**  
**Thöläuer Straße 25**  
**95615 Marktredwitz / Germany**  
**T: +49 9231 802-0**  
**F: +49 9231 802-330**  
**www.wall-systems.com**